

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2014 年 12 月 4 日(04.12.2014)



(10) 国際公開番号

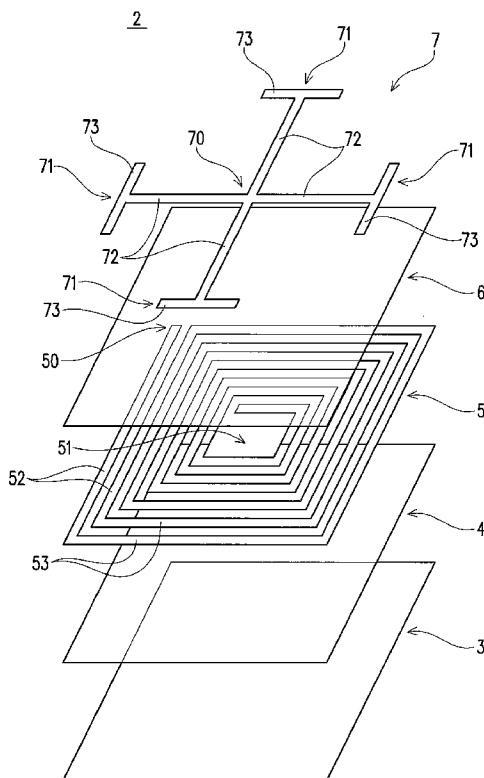
WO 2014/192784 A1

- (51) 国際特許分類:
H01Q 1/52 (2006.01) *H05K 1/02* (2006.01)
H01Q 15/14 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2014/064060
- (22) 国際出願日: 2014 年 5 月 28 日(28.05.2014)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2013-114226 2013 年 5 月 30 日(30.05.2013) JP
- (71) 出願人: 日東電工株式会社(NITTO DENKO CORPORATION) [JP/JP]; 〒5678680 大阪府茨木市下穂積 1 丁目 1 番 2 号 Osaka (JP).
- (72) 発明者: 上田 哲也(UEDA, Tetsuya); 〒6068585 京都府京都市左京区松ヶ崎橋上町 1 番地 国立大学法人京都工芸繊維大学内 Kyoto (JP). 畑中 武蔵(HATANAKA, Takezo); 〒5678680 大阪府茨木市下穂積 1 丁目 1 番 2 号 日東電工株式会社内 Osaka (JP).
- (74) 代理人: 藤本 昇(FUJIMOTO, Noboru); 〒5420081 大阪府大阪市中央区南船場 1 丁目 1 5 番 1 4 号 堺筋稲畑ビル 2 階 Osaka (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーロシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI

[続葉有]

(54) Title: EBG STRUCTURE

(54) 発明の名称: EBG構造



(57) Abstract: This EBG structure is provided with: a ground substrate; a first dielectric layer laminated upon said ground substrate; a first conductor pattern laminated upon said first dielectric layer, and having an outer edge and an inner edge, said outer edge being electrically connected to the ground substrate; a second dielectric layer laminated upon said first conductor pattern; and a second conductor pattern laminated upon said second dielectric layer, and having a center section and an outer edge, said center section being electrically connected to the inner edge of the first conductor pattern.

(57) 要約: 本発明に係る EBG 構造は、グラウンド基板と、該グラウンド基板に積層された第一の誘電層と、該第一の誘電層に積層され、外端及び内端を有する第一の導体パターンであって、該外端がグラウンド基板に電氣的に接続された第一の導体パターンと、該第一の導体パターンに積層された第二の誘電層と、該第二の誘電層に積層され、中心部及び外端を有する第二の導体パターンであって、該中心部が第一の導体パターンの内端に電氣的に接続された第二の導体パターンとを備える。

WO 2014/192784 A1

WO 2014/192784 A1



(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))